# METHOD OF DETECTING INCLINATION OF SUBSTRATE AND APPARATUS OF SENSING SUBSTRATE

Patent Number:

JP11233595

Publication date:

1999-08-27

Inventor(s):

TAKEYA KIMIO; YAMATSU YASUYOSHI

Applicant(s):

**CANON INC** 

Requested Patent:

☐ JP11233595

Application Number: JP19980046336 19980213

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/68

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PROBLEM TO BE SOLVED: To do so that the efficient detection also adaptable to a large substrate can be done, without lowering the throughput or obstructing the substrate transport by mutually independently holding and moving light emitting means and photodetecting means and comparing the apparent thickness of the substrate with its actual thickness.

SOLUTION: In case a semiconductor wafer 3 is housed in a front-open cassette 2, the distance D of an L-type arm 22 moves while a light beam 15 from a light emitting element 12 is not detected by a line photodetecting element 22 is an apparent thickness of a semiconductor wafer 3. Whether the semiconductor wafer 3 is correctly horizontally or inclined housed can be detected by comparing the apparent thickness of the semiconductor wafer 3 obtd. by such measurement with its actual thickness obtd. by a previous measurement or inclined.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-233595

(43)公開日 平成11年(1999)8月27日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

H01L 21/68

FΙ

F

H01L 21/68

審査請求 未請求 請求項の数10 FD (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平10-46336

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

(22)出願日

平成10年(1998) 2月13日

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 竹谷 公男

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ

ン株式会社内

(72)発明者 山津 康義

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ

ン株式会社内

(74)代理人 弁理士 伊東 哲也 (外2名)

## (54) 【発明の名称】 基板傾き検出方法および基板検知装置

# (57)【要約】

【課題】 簡単な構成により大型の基板にも対応した効率的な検出が行えるようにする。

【解決手段】 基板収納器の各基板収納位置の一方の側の固定された位置から各基板収納位置へ向けて光を放射する発光手段と、受光手段と、この受光手段が発光手段から放射される光を各基板収納位置の他方の側で検出するように受光手段を前記基板収納位置の配列方向に沿って移動させる移動機構と、受光手段の前記配列方向に沿った位置および受光手段の出力に基づいて各基板収納位置における基板の有無または状態を判定する判定手段とを備える。発光手段により基板へ向けて光を放射するとともに、この光を、受光手段を基板の厚さ方向に移動させつつ受光手段で検出することにより基板の傾きを検出する。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板収納器に収納された基板の傾きを検出する基板傾き検出方法であって、前記基板の一方の側に発光手段を固定してこの発光手段により前記基板の向けて光を放射するとともに、この光を、前記基板の他方の側において受光手段を前記基板の厚さ方向に移動させつつ前記受光手段で検出することによって、前記基板の見かけ上の厚さを実際の基板の厚さと比較することにより前記基板の傾きを検出することを特徴とする基板傾き検出方法。

【請求項2】 基板収納器の各基板収納位置における基板の有無または状態を検出する基板検知装置であって、各基板収納位置の一方の側の固定された位置から各基板収納位置へ向けて光を放射する発光手段と、受光手段と、この受光手段が前記発光手段から放射される光を各基板収納位置の他方の側で検出するように前記受光手段を前記基板収納位置の配列方向に沿って移動させる移動機構と、前記受光手段の前記配列方向に沿った位置および前記受光手段の出力に基づいて各基板収納位置における基板の有無または状態を判定する判定手段とを具備することを特徴とする基板検知装置。

【請求項3】 前記発光手段は面発光素子であることを 特徴とする請求項2に記載の基板検知装置。

【請求項4】 前記基板収納器は前扉を備えた密閉型のものであり、前記基板検知装置はさらに、前記配列方向に見てL字型であってそのL字型の一端近傍から光の放射が行われるように前記発光手段を保持するL型部材と、前記前扉が開かれたときに前記各基板収納位置へ向けた光の放射が行われるように、前記L型部材を各基板収納位置の一方の側に固定されるように駆動するL型部材駆動手段と、前記配列方向に見てL字型で、そのL字型の一端近傍に前記受光手段が設けられたアーム状部材とを有し、また、前記移動機構は、前記前扉が開かれたときに前記受光手段が各基板収納位置の他方の側に位置するように前記アーム状部材を駆動するものであることを特徴とする請求項2または3に記載の基板検知装置。

【請求項5】 発光手段と、この発光手段が基板収納器の各基板収納位置の一方の側から各基板収納位置へ向けて光を放射するように前記発光手段を前記基板収納位置の配列方向に沿って移動させる移動機構と、各基板収納位置の他方の側に固定され、前記発光手段から各基板収納位置へ向けて放射される光を前記他方の側で検出する受光手段と、前記発光手段の前記配列方向に沿った位置および前記受光手段の出力に基づいて各基板収納位置における基板の有無または状態を判定する判定手段を備えた基板検知装置において、前記基板検知装置はさらによれ、前記基板検知装置において、前記基板検知装置はさらに表た密閉型のものであり、前記基板検知装置はさらに表表を構えた密閉型のものであり、前記基板検知装置はさらに表表を構造した。

て前記受光手段を保持するL型部材と、前記前扉が開かれたときに各基板収納位置へ向けて放射される前記光を受光するように、前記L型部材を各基板収納位置の前記他方の側に固定すべく駆動するL型部材駆動手段とを有し、また、前記移動機構は、前記前扉が開かれたときに前記発光手段が各基板収納位置の前記一方の側に位置するように前記アーム状部材を駆動するものであることを

2

【請求項6】 前記受光手段はライン型のフォトセンサ 10 であることを特徴とする請求項5に記载の基板検知装 置。

特徴とする基板検知装置。

【請求項7】 前記受光手段は、各基板収納位置へ向けて放射される前記光を集光する集光器と、その集光位置に配置したフォトセンサとを有することを特徴とする請求項5に記載の基板検知装置。

【請求項8】 前記アーム状部材および移動機構ならび に前記L型部材およびL型部材駆動手段は前記前扉の左 右に設けられていることを特徴とする請求項4~7のい ずれか1項に記載の基板検知装置。

【請求項9】 前記基板収納器は被露光基板を収納する ものであって、かつ露光装置に対して前記前扉部分を介 して密閉して接続されるものであり、前記アーム状部材 および移動機構ならびに前記し型部材およびし型部材駆 動手段は前記基板収納器が接続される露光装置部分の内 壁に設けられており、前記移動機構は前記基板収納器が 前記露光装置に接続されたときに前記アーム状部材を、 そのL字型の1辺が各基板収納位置の一方の側に挿入さ れ、他辺が前記露光装置の内壁に沿うように駆動させる とともに、このように駆動された前記アーム状部材を前 記配列方向に沿って移動させるものであり、前記し型部 材駆動手段は、前記基板収納器が前記露光装置に接続さ れたときに前記し型部材を、そのL字型の1辺が各基板 収納位置の他方の側に挿入され、他辺が前記露光装置の 内壁に沿うように移動させるものであることを特徴とす る請求項4~7のいずれか1項に記載の基板検知装置。

【請求項10】 前記移動機構は、回転駆動により、前記アーム状部材をそのL字型の1辺が各基板収納位置の一方の側に挿入され、他辺が前記露光装置の内壁に沿うように駆動させるものであり、前記L型部材駆動手段は前記L型部材を、リンクアームを有する平行クランク機構により移動させるものであることを特徴とする請求項9に記載の基板検知装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板搬送装置等に 適用される基板傾き検出方法および基板検知装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】従来、例えば複数枚の半導体ウエハを収 50 納したカセットから1枚ずつ半導体ウエハを取り出して

3

搬送するウエハ搬送装置が知られている。さらに、かかるウエハ搬送装置として、搬送基台にピンセットを設け、このピンセットの上面に半導体ウエハを競置して保持し、この状態で搬送基台を移動させることにより、半導体ウエハの搬送を行うものが知られている。

【0003】このようなウエハ搬送装置を用いて、ウエハカセットに収納された半導体ウエハを取り出す場合は、まずウエハ搬送装置を移動手段により移動させて、ウエハカセット内の半導体ウエハの下側にピンセットを挿入する。続いて、そのまま搬送基台を上昇させることによりピンセット上に半導体ウエハを載置して保持し、この状態で搬送基台を後退させることにより、半導体ウエハを取り出すことができる。なお、ウエハカセット内の各半導体ウエハは、ウエハカセットの両側に設けられた溝の各段に挿入されており、僅かであるが水平状態が乱れて収納されている。

【0004】このようにしてウエハカセットから半導体 ウエハを自動化されたウエハ搬送装置により取り出す場 合、ウエハカセット内の各段に実際に半導体ウエハが収 納されているか否かを予め確認しておくことが一般に行 われている。このように、例えばウエハカセットに、半 導体ウエハが収納されているか否かを検知する手段とし て、従来は、ウエハの端面で光ビームを反射させてウエ ハを検知する反射型のセンサ手段や、ウエハカセットの 前後方向に光ビームを放射して、ウエハカセットをウエ ハの厚み方向に移動させ、光ビームの透過または遮光に よりウエハを検知するセンサ手段や、ウエハカセット内 のウエハの存在領域までアームを挿入し、ウエハカセッ トの左右方向に光ビームを放射して、アームを具備した ウエハ搬送装置をウエハの厚み方向に移動させ、光ビー ムの透遮光によりウエハを検知するセンサ手段などが設 けられている。

## [0005]

図る手段の1つとして、クリーンルーム自体のクリーン度を下げることが検討されている。このような環境の中でのウエハカセットの搬送は、クリーン度が保たれるような密閉型の容器の中にウエハカセットを収納して、ウエハカセット内の半導体ウエハがクリーンルーム内の大気に触れずに露光装置内に搬送されるように行われる。【0006】さらに半導体ウエハの大型化に伴い、フロントオープンカセットと呼ばれる、例えば前扉を備えた密閉型の容器であって、その中にウエハカセットを収納するようなボックス、または前扉を備えた密閉型の容器であって、ウエハカセットと一体化したようなボックスが検討されている。このようなフロントオープンカセットの作扉を露光装置内への搬入は、露光装置下側に設置されたドアオープナと呼ばれる、フロントオープンカセットの前扉を露光装置内から開閉する機構を

【発明が解決しようとする課題】近年、ローコスト化を

光装置とフロントオープンカセットを密着させ、フロントオープンカセット内の半導体ウエハがクリーンルーム内の大気に触れないような状態でドアオープナによりフロントオープンカセットの前扉を開き、露光装置内のウエハ搬送装置によりフロントオープンカセット内の半導体ウエハを取り出すような手段で行われる。

【0007】しかしながら、このようなフロントオープンカセット内の半導体ウエハを検知する場合、反射型の検知方式では、半導体ウエハの端面の状態(ウエハの反射率、オリフラ、ノッチ等)に影響されやすく、半導体ウエハの正確な検知は困難である。また、ウエハカセットに対して前後方向に光ビームを放射して半導体ウエハを検知する方式では、フロントオープンカセットのような密閉型のボックスでは光ビームを透過させることができないため、半導体ウエハの検知は不可能である。

【0008】そのような中で、ウエハカセット内の半導 体ウエハの存在領域までアームを挿入し、ウエハカセッ トの左右方向から光ビームを放射する半導体ウエハの検 知方式は、フロントオープンカセットのような、ウエハ カセットの開口部が1箇所の場合には有効な手段であ る。しかしながら、2本または1対のアームをウエハ搬 送装置の搬送基台に設置した場合、半導体ウエハの検知 を行っている時には半導体ウエハの搬送を行うことがで きず、結果としてスループットが下がるという欠点があ る。また、半導体ウエハを2本または1対のアームで挾 み込む形態のため、半導体ウエハが大型化すればアーム の幅を広げなければならず、結果としてウエハ搬送装置 自体が大型化し、重量が増加するだけでなく、ウエハ搬 送時にはアームが邪魔になるという欠点がある。さら に、半導体ウエハの大型化はつまりはウエハ検出領域の 拡大であり、検出する距離が長くなれば検出機構の僅か な位置ずれもウエハ検出には大きく影響することとな り、例えば2本の独立したアームを同期させて移動し半 導体ウエハを検出する場合、この2本のアームの移動に は高い同期精度が要求されることとなる。

【0009】本発明の目的は、このような従来技術の問題点に鑑み、基板傾き検出方法および基板検知装置において、スループットを低下させたり基板搬送を妨害することなく効率的な検出が行えるようにすることにある。また、大型の基板についても装置を大型化させたり装置の重量を増加させたりすることなく、コンパクトで簡単な構成により精度良く検出することができるようにすることにある。また、高い同期精度が要求されることなく大型の基板にも対応した検出が行えるようにすることにある。

## [0010]

ト内の半導体ウエハの露光装置内への搬入は、露光装置 下側に設置されたドアオープナと呼ばれる、フロントオ ープンカセットの前扉を露光装置内から開閉する機構を 有する装置上にフロントオープンカセットを載置し、露 50 側に発光手段を固定してこの発光手段により前記基板へ

5

向けて光を放射するとともに、この光を、前記基板の他 方の側において受光手段を各基板の厚さ方向に移動させ つつ前記受光手段で検出することによって、前記基板の 見かけ上の厚さを測定し、この見かけ上の厚さを実際の 基板の厚さと比較することにより前記基板の傾きを検出 することを特徴とする。これによれば、発光手段を固定 し、その間、受光手段のみを移動させて測定するように したため、発光手段と受光手段の同期した移動を必要と せず、かつ発光手段および受光手段を分離独立させて保 持・移動させることができる。したがって、大型の基板 の場合でも、コンパクトで簡便な構成により基板の傾き が検出される。

【0011】また、本第2発明においては、基板収納器の各基板収納位置における基板の有無または状態を検出する基板検知装置において、各基板収納位置の一方の側の固定された位置から各基板収納位置へ向けて光を放射する発光手段と、受光手段と、この受光手段が前記発光手段から放射される光を各基板収納位置の他方の側で検出するように前記受光手段を前記基板収納位置の配列方向に沿って移動させる移動機構と、前記受光手段の前記配列方向に沿った位置および前記受光手段の出力に基づいて各基板収納位置における基板の有無または状態を判定する判定手段とを具備することを特徴とする。これによっても同様に、大型の基板についてもコンパクトで簡便な構成により、基板の傾きが検出される。

【0012】また、本第3発明においては、発光手段 と、この発光手段が基板収納器の各基板収納位置の一方 の側から各基板収納位置へ向けて光を放射するように前 記発光手段を前記基板収納位置の配列方向に沿って移動 させる移動機構と、各基板収納位置の他方の側に固定さ れ、前記発光手段から各基板収納位置へ向けて放射され る光を前記他方の側で検出する受光手段と、前記発光手 段の前記配列方向に沿った位置および前記受光手段の出 力に基づいて各基板収納位置における基板の有無または 状態を判定する判定手段とを備えた基板検知装置におい て、前記基板収納器は前扉を備えた密閉型のものであ り、前記基板検知装置はさらに、前記配列方向に見てL 字型で、そのL字型の一端近傍に前記発光手段が設けら れたアーム状部材と、前記配列方向に見てL字型であっ て、そのL字型の一端近傍において前記受光手段を保持 するL型部材と、前記前扉が開かれたときに各基板収納 位置へ向けて放射される前記光を受光するように、前記 L型部材を各基板収納位置の前記他方の側に固定すべく 駆動するL型部材駆動手段とを有し、また、前記移動機 構は、前記前扉が開かれたときに前記発光手段が各基板 収納位置の前記一方の側に位置するように前記アーム状 部材を駆動するものであることを特徴とする。これによ れば、発光手段および受光手段をL字型のアーム状部材 およびL型部材により保持し、基板収納器に対して別個 に駆動して配置するようにしたため、よりコンパクトな

構成が可能となるとともに、大きな基板に対する対応も 容易となる。

[0013]

【発明の実施の形態】本第2発明の好ましい形態におい ては、各基板の一方の側に固定される発光手段として、 面発光素子が用いられる。また、基板収納器は前扉を備 えた密閉型のものであり、基板検知装置はさらに、基板 収納位置の配列方向に見てL字型であってそのL字型の 一端近傍から光の放射が行われるように発光手段を保持 するL型部材と、前記前扉が開かれたときに各基板収納 位置へ向けた光の放射が行われるように、前記L型部材 を各基板収納位置の一方の側に固定されるように駆動す るL型部材駆動手段と、前配配列方向に見てL字型で、 そのL字型の一端近傍に前記受光手段が設けられたアー ム状部材とを有し、また、前記移動機構は、前記前扉が 開かれたときに前記受光手段が各基板収納位置の他方の 側に位置するように前記アーム状部材を駆動するもので ある。これにより、本第2発明と同様に、構成のよりコ ンパクト化や大基板に対する対応の容易化が図られる。 【0014】本第3発明において、受光手段としては、 ライン型のフォトセンサや、各基板収納位置へ向けて放 射される光を集光する集光器と、その集光位置に配置し たフォトセンサとを有するものを用いることができる。 【0015】さらに、かかる本第2、第3発明の形態に おいて、アーム状部材および移動機構ならびに前記し型 部材およびL型部材駆動手段は前記前扉の左右に設けら れている。より具体的な態様では、基板収納器は被露光 基板を収納するものであってかつ露光装置に対して前記 前扉部分を介して密閉して接続されるものであり、前記 アーム状部材および移動機構ならびに前記L型部材およ びL型部材駆動手段は基板収納器が接続される露光装置 部分の内壁に設けられており、前記移動機構は基板収納 器が露光装置に接続されたときに前記アーム状部材を、 そのL字型の1辺が各基板収納位置の一方の側に挿入さ れ、他辺が露光装置の内壁に沿うように駆動させるとと もに、このように駆動されたアーム状部材を基板収納位 置の配列方向に沿って移動させるものであり、前記し型 部材駆動手段は、基板収納器が露光装置に接続されたと きに前記し型部材を、そのし字型の1辺が各基板収納位 置の他方の側に挿入され、他辺が露光装置の内壁に沿う ように移動させるものである。前記移動機構としては、 回転駆動により、前記アーム状部材をそのL字型の1辺 が各基板収納位置の一方の側に挿入され、他辺が露光装 置の内壁に沿うように駆動させるものを用いることがで き、前記L型部材駆動手段としては、前記L型部材を、 リンクアームを有する平行クランク機構により移動させ るものを用いることができる。

【0016】かかる基板検知装置では、例えば前述の移動手段によって昇降するL字型のアーム状部材の先端に 50 設けられた発光手段と、前述のL型部材としてのボック

ス状部材の内部に設けられ、発光手段から照射された光 ビームを検出するライン型の受光手段とを、例えば半導 体ウエハ等の基板が存在するべき領域(基板収納位置) を挟み込むように、基板収納位置の一方の側と他方の側 へ移動し、前記基板を左右方向から検出する。発光手段 と受光手段との間の基板収納位置に基板が存在する場合 は、発光手段から放射された光ビームは基板によって遮 られるので、基板の有無または状態を検出することがで きる。

【0017】さらに、かかる基板検知装置では、発光手段および受光手段を独立した機構上に設け、発光手段または受光手段のどちらか一方は移動し、もう一方は固定としたことにより、例えば発光手段および受光手段を同時に移動させる際の高い同期精度は必要とせずに、基板の有無または状態を検出することができる。

【0018】さらに基板検知装置を基板搬送装置から分離し、露光装置の内壁等に設けることによって、基板検知時においても基板搬送装置を稼働させることを可能にし、また、基板を検知するための発光手段と受光手段を独立して露光装置内部の、基板収納器前部扉の両脇の位置に設置することで、基板収納器前部扉の開閉機構の邪魔になるのを防止し、例えば半導体ウエハの大型化によるウエハ幅の拡大による影響も少なくなる。

【0019】なお、基板有無の検知に際しては、具体的には、L型のアーム状部材およびL型部材を基板収納位置の周面外側に位置するように挿入して、アーム状部材を基板の厚さ方向(基板収納位置の配列方向)に移動させ、各基板収納位置において発光手段が検出しなくなったらその基板収納位置においては基板が有ると判断する。また、その際、発光手段からの光ビームを受光手段が検出しなくなってから再度検出するまでのアーム状部材の移動距離により基板の見かけ上の厚さを測定し、この見かけ上の厚さが実際の厚さよりも大きい場合は、基板が傾いていると判断する。

# [0020]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を用いて 説明する。図1は、本発明の一実施例に係る基板検知装 置の構成を概略的に示すものであり、図1 (a) は上面 図、図1 (b) は正面図である。また、図2はこの基板 検知装置の基板検知動作を概略的に示す透視図であり、 図2 (a) は上面図、図2 (b) は正面図である。これ らの図に示すように、基板検知装置1は、露光装置パネ ル4の内面にあり、フロントオープンカセット2から半 導体ウエハ3を搬入するための前扉開口部5の両脇に設 置されているL型アーム機構部10と、L型ボックス機 構部20と、基板検知判定回路(図示せず)により構成 されている。

【0021】 L型アーム機構部10は、細くL字型の棒状に形成されたL型アーム11と、L型アーム11先端部に設けられた発光素子12 (例えば赤外線LED)

と、L型アーム11を回転移動するための回転駆動機構 13 (例えばモータ)と、L型アーム11が回転しすぎることを防止するためのアームストッパ14と、L型アーム11を昇降するための図示していない昇降機構 (例えばボールネジ、エアーシリンダ等)とにより構成されている。L型アーム機構部10は、L型アーム11を回転駆動機構13により回転移動し、L型アーム11先端部の発光素子12を前扉開口部5からフロントオープンカセット2内の半導体ウエハ3の周面外側へ挿入し、発光素子12からウエハ検出用の光ビーム15 (例えば赤外線)を半導体ウエハ3の左右方向に放射しつつ、L型アーム11を昇降機構により半導体ウエハの厚み方向へ移動することができる。

【0022】L型ボックス機構部20は、薄い密閉した L字型の容器で形成されたL型ボックス21と、L型ボ ックス21に連結したリンクアーム24aおよび24b と、パネル4の内面に固定された、リンクアーム24 a を回転するための回転駆動機構23 (例えばモータ) と、パネル4の内面に固定された、リンクアーム24b を支持するためのアーム支持部25と、L型ボックス2 1先端部にあり、フロントオープンカセット2内部のウ エハ検出領域と同等の高さに形成された、外乱光を除去 しウエハ検出用の光ビーム15のみを抽出する透過フィ ルタ26 (例えば赤外線透過フィルタ) と、L型ボック ス21内部にあり、前記ウエハ検出領域と同等の高さに 形成された、透過フィルタ26により抽出した光ビーム 15を検出するライン受光素子22 (例えば赤外線フォ トダイオード)とにより構成されている。L型ボックス 機構部20は、L型ボックス21を回転駆動機構23と リンクアーム24aおよび24bとにより露光装置パネ ル4に対して平行に移動しながらし型ボックス21先端 部のライン受光素子22を前扉開口部5からフロントオ ープンカセット2内の半導体ウエハ3の周面外側へ挿入 することにより、前述のL型アーム11に設けられた発 光素子12から放射されたウエハ検出用の光ビーム15 をライン受光素子22により検出することができる。

【0023】基板検知判定回路は、かかる基板検知機構を用いて、L型ボックス機構部20のライン受光素子22の出力信号により半導体ウエハの有無および傾きを判定するとともに、L型アーム機構部10の半導体ウエハの厚み方向に対する位置情報によりフロントオープンカセット2内の半導体ウエハ3の存在するスロット位置を判定する。

【0024】以下に、L型ボックス機構部20の構成の 詳細および原理を、図2および図3を用いて説明する。 なお、図3はL型ボックス21の構成を概略的に示すも のであり、図3(a)は上面図、図3(b)は正面図、 図3(c)は側面図である。L型ボックス21はカセッ ト内挿入部21aとボックス支持部21bをL字型につ ないだように形成されている。L型ボックス21の高さ

hはフロントオープンカセット 2内の高さに合わせて形成されている。L型ボックス 21の奥行き d (カセット内挿入部 21a)はL型ボックス 21をフロントオープンカセット 2内に挿入した際に、フロントオープンカセット 2内のウエハ周面外側から半導体ウエハ 3が存在すべき領域を光ビーム 15が通過し、かつ半導体ウエハ 3 およびフロントオープンカセット 2と干渉しないような長さとなっており、また厚み t は、前述と同様に半導体ウエハ 3 およびフロントオープンカセット 2と干渉しないように薄く形成されている。

【0025】リンクアーム24aおよび24bはL型ボックス21の奥行きd(カセット内挿入部21a)よりも長く形成されている。リンクアーム24bの一方の先端は回転駆動機構23に、またリンクアーム24aの一方の先端は露光装置パネル4の内面に固定されたアーム支持部25の支持ピンにそれぞれ連結されており、回転駆動機構23とアーム支持部25の取り付け位置はオフセットされている。リンクアーム24aおよび24bの他方の先端はL型ボックス21のボックス支持部21bにそれぞれ支持ピンにより連結されており、それらの連結位置は前述のオフセット量と同じだけオフセットされている。

【0026】 L型ボックス機構部20は、L型ボックス21とリンクアーム24aおよび24bにより平行クランクを構成しており、回転駆動機構23が回転するとリンクアーム24aおよび24bの先端に連結されたL型ボックス21は、その姿勢(角度)を保持しながら露光装置パネル4に対して弧を描くように平行移動し、L型ボックス21のカセット内挿入部21aがフロントオープンカセット2内に挿入される。L型ボックス21はリンクアーム24aおよび24bにより露光装置パネル4の内面にボックス支持部21bが押しつけられることで、平行度および停止位置の再現性を確保している。

【0027】以下に、このような基板検知装置1によりフロントオープンカセット2内に収納された半導体ウエハの有無および傾きを検出する方法について、図2および図4を用いて説明する。なお、図4は本基板検知装置1による基板検出の原理を概略的に示すものである。露光装置にフロントオープンカセット2が接続されたとき、基板検知装置1のL型アーム機構部10およびL型ボックス機構部20は図2(a)中の点線で示す待機位置にある。

【0028】このとき、ドアオープナ(図示せず)により露光装置の内側からフロントオープンカセット2の前扉が開かれると、まず、L型アーム機構部10をフロントオープンカセット2内の半導体ウエハ3と確実に干渉しない位置まで上昇させ、L型アーム11を待機位置からアームストッパ14まで回転駆動機構13により回転させて、L型アーム11先端部に設けられた発光素子12を半導体ウエハ3の周面外側の上位置に挿入する。同

10

時にL型ボックス21を回転駆動機構23とリンクアーム24aおよび24bにより露光装置パネル4に対して平行移動しながらL型ボックス21先端部のライン受光素子22を前述と同様にフロントオープンカセット2内の半導体ウエハ3の周面外側に挿入する。

【0029】次に、発光素子12からウエハ検知用の光ビーム15の放射を開始する。このとき、発光素子12からライン受光素子22までの光ビーム15の経路上には半導体ウエハ3は存在していないので、発光素子12から放射された光ビーム15はL型ボックス21内の透過フィルタ26を経由してライン受光素子22に検出され、その結果、ウエハ無しと判定される。

【0030】続いて、図2(b)の矢印Aで示すよう に、L型アーム11を昇降機構(図示せず)により下降 させる。ここで、L型アーム11が最上段に収納された 半導体ウエハ3の高さまで下降すると、発光素子12か ら放射された光ビーム15はウエハ3のL型アーム機構 部10寄りの周面により遮断され、ライン受光素子22 では光ビーム15は検出されず、ライン受光素子22は ウエハ検知情報を出力する。このライン受光素子22か らのウエハ検知情報とL型アーム機構部10の昇降機構 からの位置情報により、基板検知判定回路は、フロント オープンカセット2内の検知位置に半導体ウエハ3が収 納されていることを検知することができる。そして、順 次L型アーム11をフロントオープンカセット2の最下 段の収納位置の高さまで下降させて、フロントオープン カセット2内の各段についてウエハ有無の検知および判 定を実施する。

【0031】またこのとき、半導体ウエハ3がフロント オープンカセット2内の各段の溝に水平方向に正しく収 納されているかあるいは傾いた状態で収納されているか を、各半導体ウエハ3の見かけ上の厚さを測定すること によって判定することが可能である。すなわち、半導体 ウエハ3がフロントオープンカセット2内に収納されて いる場合、図4に示すように、矢印Aで示した方向にL 型アーム11を下降させると、発光素子12から放射さ れた光ビーム15が半導体ウエハ3により遮断されてラ イン受光素子22に検出されないのは、L型アーム11 が高さaに達してから、高さcに達するまでの移動区間 である。したがって、発光素子12から放射された光ビ ーム15がライン受光素子22に検出されない間(例え ば高さb)にL型アーム11が移動した距離Dは、この ときの半導体ウエハ3の見かけ上の厚さとなる。この移 動距離Dは半導体ウエハ3が水平方向に正しく収納され ている場合は半導体ウエハ3の実際の厚さと一致し、傾 いた状態で収納されている場合は半導体ウエハ3の実際 の厚さよりも長くなり、半導体ウエハ3の実際の厚さと 一致しなくなる。したがって、基板検知判定回路で、こ のような測定によって得られた半導体ウエハ3の見かけ 上の厚さを、あらかじめ測定によって得られた半導体ウ

50

エハ3の実際の厚さと比較することにより、半導体ウエ ハ3が水平方向に正しく収納されているか、傾いた状態 で収納されているかを検出することができる。

【0032】以上のようにしてフロントオープンカセッ ト2内の各段の収納位置における半導体ウエハ3の有無 および状態が基板検知判定回路に保存、つまりマッピン グされる。なお、L型アーム11の形状はL字型の棒状 になっており、フロントオープンカセット2への挿入時 にもスペースをとらない。また、L型アーム11は、半 導体ウエハ3が存在しないフロントオープンカセット2 の最上部位置で回転挿入され、さらにその挿入部21 a の挿入位置はL型アーム11自体の形状およびアームス トッパ14により制限されているので、L型アーム11 の挿入により半導体ウエハ3およびフロントオープンカ セット2に干渉し、これらを破損させることはない。

【0033】また、L型ボックス機構部20は、L型ボ ックス21、回転駆動機構23ならびにリンクアーム2 4 a および 2 4 b により平行クランクを構成しているた め、L型ボックス21をフロントオープンカセット2内 へ挿入するために必要な平行移動および挿入動作とい う、横方向と縦方向の2種類の動作を回転駆動機構23 による回転動作1つで行うことができる。また、前述の ようにL型ボックス機構部20は平行クランクを構成し ているため、L型ボックス21のカセット内挿入部21 aをフロントオープンカセット2内へ挿入したときの移 動スペースは最小限であり、例えば同じようなL型ボッ クスの光ビーム導光部を回転駆動によりフロントオープ ンカセット2内へ挿入したときの移動スペースよりもか なり少なくすることが可能である。したがって、L型ボ ックス21のカセット内挿入部21aをより長くするこ とが可能となり、フロントオープンカセット2内の半導 体ウエハ3と干渉することなく、より確実に検知できる 領域まで挿入することができる。

【0034】図5は本発明の他の実施例に係る基板検知 装置におけるL型ボックスの内部構成を示す。このL型 ボックスでは、前述の実施例の受光手段であるライン受 光素子22の代わりに受光素子と集光器を用いている。 このような構成としても、前述の実施例と同様に、受光 手段を固定した状態でフロントオープンカセット2内に 収納された半導体ウエハ等の基板を検知することができ る。

【0035】すなわち、図5で示すL型ポックスでは、 L型ボックス21のカセット挿入部21aの先端にはフ ロントオープンカセット2内部のウエハ検出領域と同等 の高さでスリット33が開いており、発光素子12から 放射された光ビーム15はこのスリット33からL型ボ ックス21内部へ導入される。カセット内挿入部21a 内部には反射体31a、31b(例えばミラー)および 透過フィルタ26が設けられており、スリット33から 入射した光ビーム15はこの反射体31aと31bによ 50 ずしもその装置に取り付ける必要はなく、例えばウエハ

12

り反射され、ボックス支持部21bへ導光される。ボッ クス支持部21 b内部には集光器32 (例えば凸レン ズ)と受光素子22が設けられており、カセット内挿入 部21aから導光された光ビーム15は集光器32によ り集光され、受光素子22により検出される。

【0036】本発明のさらなる実施例として、例えば前 述の実施例ではL型アーム機構部10に発光素子12を 設け、L型ボックス機構部20にライン受光素子22を 設けた構成であったが、逆にL型アーム機構部10に受 光素子を設け、L型ボックス機構部20に面発光素子を 設けた構成としても、同様の基板検知を行うことができ る。要するに、発光手段または受光手段のどちらかを固 定し、もう一方を移動することにより、基板の検知を行 う構成であればよい。

【0037】さらに本発明は上述の各実施例に限定され ることなく適宜変形して実施することができる。例え ば、基板検知判定回路が半導体ウエハが傾いた状態で収 納されていると判定した場合、アラームを発生すること としてもよい。また、この傾いた状態で収納されている 20 と判定した半導体ウエハは搬入しないこととしたり、さ らにこの傾いた状態で収納されている半導体ウエハが、 その下に収納されている半導体ウエハ上に载っていると 判定された場合、この傾いた状態で収納されている半導 体ウエハと、さらにその下に収納されている半導体ウエ ハも搬入しないこととしてもよい。

【0038】また、上述においては、基板検知装置によ るウエハ検知開始時は、L型アーム11の高さ位置には 半導体ウエハは存在していないはずなので、受光素子は 発光素子から放射された光ビームを検出し、基板検知判 定回路はウエハ無しと判定することを示したが、しかし このL型アーム11の位置で基板検知判定回路がウエハ 有りと判定した場合、L型アーム11とL型ボックス2 1の位置関係が正しくないものとして、アラームを発生 させることとしてもよい。また、L型アーム11または L型ボックス21を微小に動かし、L型アーム11とL 型ボックス21の位置関係が正しくなるように初期位置 を調整するための駆動をすることとしてもよい。

【0039】また、上述実施例ではL字型のアーム11 およびL字型のボックス21を構成したが、これらの形 状は必ずしもL字型のような90度の角度を有するもの である必要はない。また、上述実施例ではL字型のボッ クス21の挿入部21aをフロントオープンカセット2 内に挿入する機構としてリンク機構を用いたが、カセッ ト内の半導体ウエハと干渉せずに、ウエハ検知領域を十 分確保できるスペースがあれば、L字型のボックス21 は回転機構等により挿入してもよい。

【0040】また、上述実施例ではフロントオープンカ セット2から半導体ウエハを搬入する前扉開口部の両脇 の露光装置内壁に基板検知装置を取り付けているが、必

30

搬送に支障がなければウエハ搬送装置上に設けてもよ い。

13

【0041】なお、半導体ウエハにはノッチウエハとオリフラウエハがあり、本発明のように半導体ウエハの左右方向から光ビームを放射して半導体ウエハの有無および傾きを検出する場合、ノッチウエハではウエハの有無および傾きの検出に何ら支障はない。しかし、オリフラウエハの場合は、ウエハ有無の検出は問題無くできるものの、オリフラ部が光ビームを遮る状態のときは、オリフラウエハの傾き検出時にその傾き具合を実際よりも小さく検出してしまう可能性がある。しかしながら、本発明で問題にしているフロントオープンカセットで搬送されるような大型のウエハはノッチウエハであり、本発明のように半導体ウエハの左右方向から光ビームを照射して有無および傾きを検出する検知方法では問題とならない。

#### [0042]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、発 光手段および受光手段を相互に独立させて保持し移動す る構成を採りながら、これら手段を同期して移動させる ことなく、1つの移動機構により、基板収納器の各基板 収納位置における基板の有無や傾きなどを検出すること ができる。したがって、大型の基板についても、装置を 大型化させたり装置の重量を増加させたりすることな く、コンパクトで簡単な構成により精度良く検出を行う ことができる。また、高い同期精度が要求されることな く大型の基板にも対応した検出を行うことができる。さ らに、基板検知装置を基板搬送装置以外の、例えば露光 装置の内壁にコンパクトに設けることが容易であり、そ れにより、基板搬送の邪魔となったりスループットを低 下させたりすることなく、効率的な基板搬送に寄与する ことができる。かかる本発明の効果は、特に、基板収納 器を載置する側に昇降機構がなく、かつ検出すべき基板 の領域の幅が長いときに有効である。

【0043】また、上記効果を奏しつつ、基板収納器に傾いた状態で収納されている基板を検出し、このような 基板を基板収納器から搬送する際のダストの発生や基板 の破損を防止することができる。

【0044】また、上記効果を奏しつつ、前扉を備えた 密閉型の基板収納器に収納された基板の有無および傾き を検出し、このような収納器から基板を搬送する場合 に、事前に基板収納器に収納された基板の位置および状態を検知することができる。

#### 10 【図面の簡単な説明】

(8)

【図1】 本発明の一実施例に係る基板検知装置の要部 概略図であり、図1 (a) は上面図、図1 (b) は正面 図である。

【図2】 図1の装置の動作を示す概略透視図であり、図2(a)は上面図、図2(b)は正面図である。

【図3】 図1の装置で使用されるL型ボックスの一例を示す透視図であり、図3(a)は上面図、図3(b)は正面図、図3(c)は側面図である。

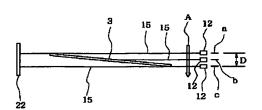
【図4】 図1の装置における基板の有無および傾きを 0 検出する原理を示す概念図である。

【図5】 本発明の他の実施例で使用されるL型ボックスの一例を示す透視図であり、図5 (a) は上面図、図5 (b) は正面図、図5 (c) は側面図である。

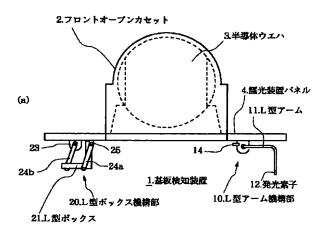
#### 【符号の説明】

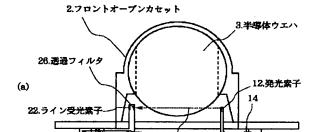
1:基板検知装置、2:フロントオープンカセット、3:半導体ウエハ、4:露光装置パネル、5:前扉開口部、10:L型アーム機構部、11:L型アーム、12:発光素子、13:回転駆動機構、14:アームストッパ、15:光ビーム、20:L型ボックス機構部、21:L型ボックス、22:受光素子(ライン受光素子)、23:回転駆動機構、24a,24b:リンクアーム、25:アーム支持部、26:透過フィルタ、31a,31b:反射体、32:集光器、33:スリット。

【図4】



【図1】



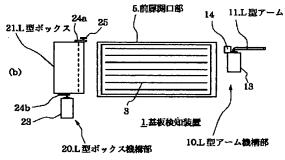


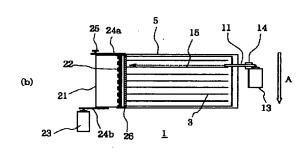
15.光ビーム

10

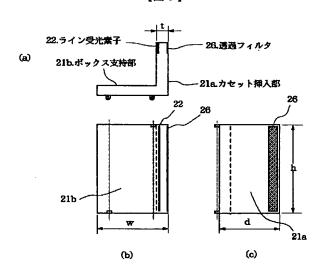
1

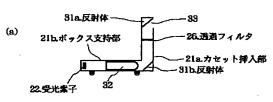
【図2】











【図5】

